

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟向华夏银行申请综合授信额度展期的议案》。

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟将与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签署的合同编号为YYB9210120190021的流动资金贷款申请展期，金额为人民币5,000万元，期限1年。具体额度、使用要求、期限和费率等以银行审批为准。

为便于公司向华夏银行申请展期工作进行顺利，董事会同意授权公司董事长王立群先生在董事会审批权限范围内签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期自本次董事会审议批准之日起一年有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年3月16日